



Ampoc Far East Co., Ltd.

揚博科技股份有限公司  
Ampoc Far-East Co., Ltd.

股票代號：2493



2022/09/16



Ampoc Far East Co., Ltd.

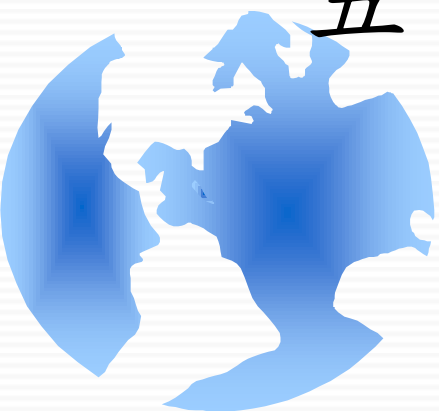
一、公司簡介

二、公司沿革

三、財務資訊

四、代理業務產業應用與產品介紹

五、自製設備產品介紹與展望





# 一、公司簡介

公司名稱	揚博科技股份有限公司
地址	台北市松德路171號17樓
電話	(02)2726-2220
董事長	蘇勝義 先生
資本額	新台幣 114,437 萬元
設立日期	1980年11月1日
員工人數	280人
公司網站	<a href="http://www.amvoc.com.tw">www.amvoc.com.tw</a>



蘇勝義先生



## 二、公司沿革

### AMPOC's History



- 2019/01 • 透過香港子公司投資Ampec Trading (Shanghai) Co., Ltd.。
- 2006/12 • 吸收合併百分之百持有之揚鑫投資股份有限公司，合併後資本額不變。
- 2002/01 • 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。
- 2001/06 • 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。
- 2000/10 • 辦理現金增資 4,800 萬元、盈餘轉增資 3,997 萬元、合併資本公積轉增資 7,424 萬元、員工紅利轉增資 401 萬元，增資後資本額為新台幣 73,729 萬元。
- 1999/12 • 合併台北化工機械股份有限公司，並增資發行新股 21,107 仟股，股本增為 57,107 萬元。
- 1998/12 • 獲准成為公開發行公司，辦理盈餘轉增資 10,200 萬元，增資後資本額為新台幣 30,000 萬元。
- 1998/03 • 設立精密儀器檢測服務實驗室，加強對客戶服務內容與品質。
- 1997/03 • 購置並遷入台北市松德路 171 號 17 樓之新辦公室。
- 1987/05 • 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。
- 1980/11 • 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。



## 三、財務資訊

### 最近年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	109年年度 (合併)	110年年度 (合併)	111年上半年 (合併)
營業收入		2,600,664	2,938,974	1,781,039
營業毛利		687,947	778,114	516,013
毛利率(%)		26.45	26.48	28.97
營業利益		397,524	453,574	370,593
稅後淨利		308,769	343,298	286,374
每股盈餘(元)		2.70	3.00	2.50



## 最近年度資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	109年 (合併)	110年年度 (合併)	111年上半年 (合併)
流動資產		2,951,161	3,145,641	3,613,578
非流動資產		697,883	695,569	655,922
資產總額		3,649,044	3,841,210	4,269,500
流動負債		1,141,638	1,282,260	1,726,742
非流動負債		153,401	119,162	126,363
負債總額		1,295,039	1,401,422	1,853,105



## 最近年度財務分析

項目	年度	109年 (合併)	110年 (合併)	111年上半年 (合併)
負債佔資產比 (%)		35.49	36.48	43.40
流動比率 (%)		258.50	245.32	209.27
存貨周轉率(次)		2.08	1.91	2.14
權益報酬率(%)		13.13	14.32	11.79



## 四、代理業務產業應用與產品介紹

### □ 產業應用

- 半導體前段
- 先進封裝製程
- 5G/AI

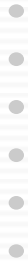
### □ 產品介紹

- AI Arm (AMPOC intelligent arm)系統
- Laser Heater TC Bonder





Ampoc Far East Co., Ltd.



## 產業應用





# 產品應用及發展方向

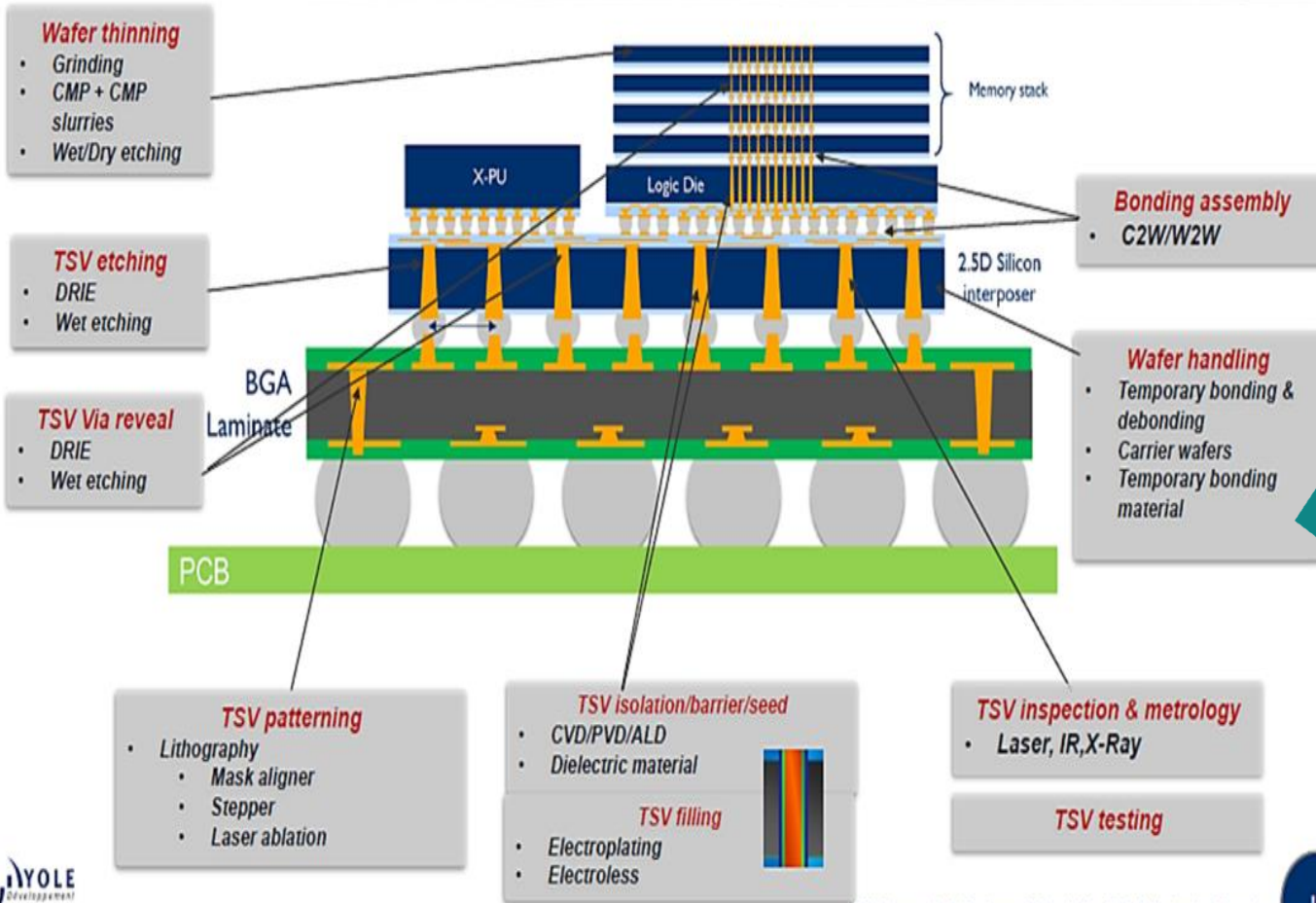
- ✓ 覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液。
- ✓ 3D-IC · FOWLP 高速電鍍藥水。
- ✓ 晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液。
- ✓ 高解析光阻液。
- ✓ Hard Mask

- ✓ 導線架 metal finish 用藥水。
- ✓ QFN導線架 電著光阻
- ✓ 高階fine pitch探針卡用MLO



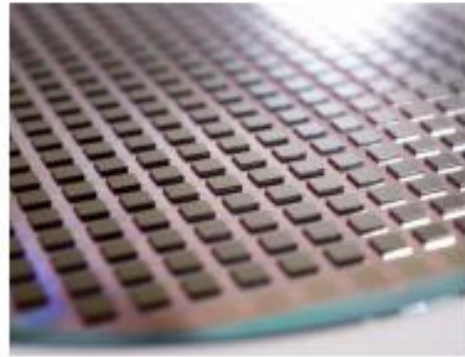
# 核心發展製程

## TSV manufacturing





# Laser Heater TC Bonder



- Fast heating and cooling
- Low thermal expansion
- Localized heating



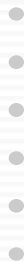


# 2022年市場狀況與未來展望

- **供應鏈供需失衡**
  - 2021-2022年超額下單現象，當時對內部及客戶庫存已經採取特別管控。
  - 中國的封控清零政策，造成供應鏈中斷、終端需求衰退，使得零組件庫存變成很嚴重的問題，後續持續觀察中國政策調整狀況。
- **因應做法**
  - 揚博在代理業務著重於高階製程設備與材料深化及拓展。
  - 美系供應鏈及中國大陸供應鏈持續布局。



Ampec Far East Co., Ltd.



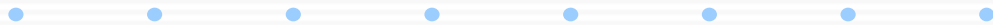
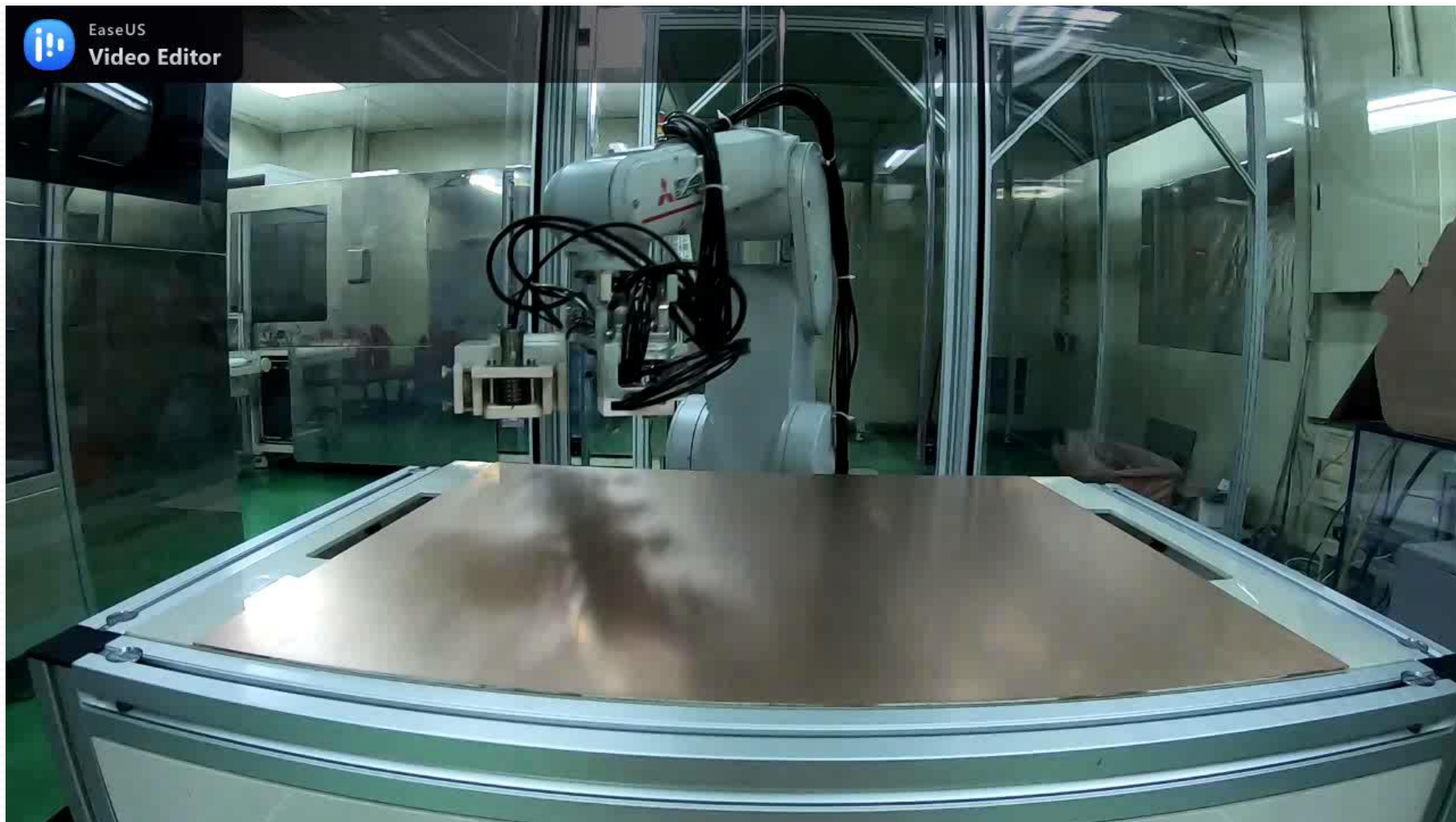
## 五、自製設備產品介紹與展望





Am poc Far East Co., Ltd.

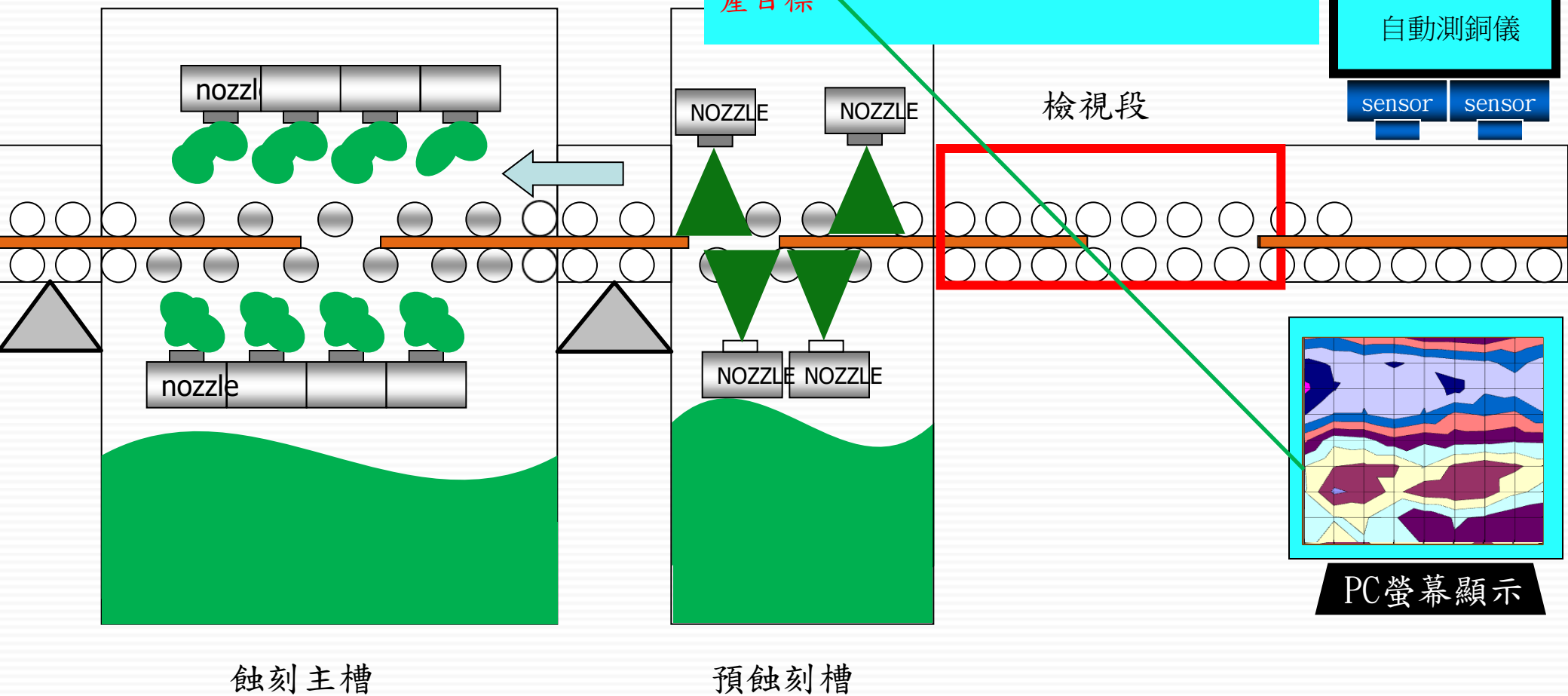
# AI Arm (AMPOC intelligent arm)系統





# 電腦化線上自動生產系統

系統連鎖：批量設定檢測，系統自動量測電鍍後銅面均勻性，將量測後之數值連線設備電腦，自動設定補償槽達到自動化生產目標





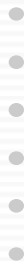


## 台灣PCB產業2021年回顧及2023年展望

- 一. 2021年全球電路板產值預估達到美金870億。台商兩岸PCB營業額市佔率:32.8%居全球第一.中國位居第二.達31.3%.日本第三.市佔率:17.2%.
- 二. 台灣在全球市場占有率奪冠，惟中國大陸的占比也持續成長的國家，其中最大關鍵就是5G、大數據、雲計算、人工智能、物聯網.自駕車等行業快速發展.使其市占率和成長率正快速上升中。
- 三. 2023年預估PCB擴充產能其產品包含載板、HDI.軟板,應用市場包含智慧型手機、汽車電子、物聯網、網通等產品市場。
- 四. 未來設備研發與需求展望：
  - 1.ABF載板高階製程設備需求。
  - 2.各PCB廠跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板.HDI.軟板設備需求。
  - 3.電動汽車與安全相關PCB設備需求。



Ampoc Far East Co., Ltd.



*Thank you*  
*The End*

